材料移轉契約

中華民國 114 年 11 月 14 日智財處第 1141702057 號簽修訂

中央研究院覽號：_____

緣中央研究院(以下簡稱「甲方」)同意將_____(以下簡稱「甲方研發人」)研發之原始材料（詳述材料名稱於本契約第二條）移轉予_____（以下簡稱「乙方」）並由_____（以下簡稱「乙方研發人」）代表乙方受領及使用，特立本契約，以資雙方遵循，並同意條件如下：

第一條： 名詞定義

一、甲方:提供原始材料之機構,機構名稱與地址詳列於本契約末之簽署頁。

二、甲方研發人：姓名與地址詳列於本契約末之簽署頁。

三、乙方:接受原始材料之機構。機構名稱與地址詳列於本契約末之簽署頁。

四、乙方研發人：姓名與地址詳列於本契約末之簽署頁。

五、原始材料：材料名稱詳述於本契約第二條。

六、本材料：包括原始材料、其子代、以及非經修改之衍生物；但不包括：(一)修改材料及(二)排除前述子代、非經修改之衍生物及修改材料，乙方利用本材料所創作出之材料。

七、子代：由本材料不經修改，直接產出之後代。如：病毒、細胞株、及其他生物體之後代。

八、非經修改之衍生物：乙方操作原始材料所產出其中帶有原始材料中未經修改的功能性次單位之材料，或產出由原始材料所表現之產物。例如：由原始細胞株複製之次代、由原始材料純化或分段分離後之成品、由甲方所提供原始DNA/RNA表達出來之蛋白質或由融合瘤細胞株所釋出的單株抗體。

九、修改材料：乙方利用包含或融合本材料所創作出的新材料。

十、商業利用：以有償目的販賣、租賃、授權或移轉等利用本材料或修改材料之行為，包括但不限於乙方利用本材料或修改材料從事資助研究計畫、篩選化合物資料庫、製造或生產作為販賣之產品，或因執行研究計畫而將本材料或修改材料販賣、租賃、授權或移轉至營利單位。除符合前述

之情事以外，接受營利單位補助之學術研究計畫且非為該營利單位發展特定研究成果而利用本材料或修改材料，非屬本項之商業利用。

十一、 非營利機構：大學或其他高等教育機構、或國內稅法認定之非營利法人團體以及政府機構（關）。

第二條：原始材料種類及名稱

□生物材料，名稱：_____（甲方覽號：_____）。

上述材料為

□人體研究生物材料

□感染性生物材料

□動物生物材料

□非生物材料，名稱：_____（甲方覽號：_____）。

第三條：本材料之使用限制

一、□本材料僅得用於教學或學術研究之用。

二、未經甲方事前書面同意，乙方及乙方研發人不得將本材料使用於人體（包括臨床試驗、診斷等）。

三、本材料僅得在乙方場所內之乙方研發人實驗室內使用，並限於由乙方研發人或其親自指導監督下之人員使用。未經甲方事前書面同意，乙方及乙方研發人不得將本材料交予前述以外之第三人，包括但不限於乙方單位之其他人員或實驗室。

四、如有非在乙方研發人親自指導監督下工作之第三人需要使用本材料，乙方及乙方研發人應轉知甲方，由甲方決定是否提供。

第四條：權利歸屬及運用

一、甲方研發人於本契約簽署後，仍保有公開發表本材料之權利。乙方或乙方研發人若以本材料或修改材料之研究成果發表相關著作或演講時，應於致謝處或文中其他合適段落引註材料來源為甲方。甲方研發人若尚未公開發表與本材料相關之著作或演講時，乙方及乙方研發人另應於其發表日之至少六十日前檢附相關資料通知甲方及甲方研發人。未經甲方事

前書面同意，乙方或乙方研發人不得發表之，但甲方無正當理由不得拒絕前述之發表。

二、甲方保有本材料以及包含於修改材料中之本材料之所有權及相關權利。乙方瞭解本材料已經或將來可能被用來申請專利。除本契約或雙方另有書面之約定外，甲方並未明示或默示同意將其發明（包括甲方對本材料之任何修改）之專利權、專利申請權、營業秘密或其他財產權授權或以其他方式授與乙方。

三、本契約中歸屬於乙方之所有權：

□本契約無涉歸屬於乙方之所有權。

□乙方得保有下列研發成果之所有權；但若該研發成果是由甲乙雙方合作所產出者，應經甲乙雙方另以書面約定所有權之歸屬：

(一) 修改材料（但不含前項所列屬甲方所有之本材料部分）；

(二) 由乙方或乙方研發人自行利用本材料或修改材料所產出之研發成果，但不包括子代、未修改之衍生物或修改材料中之本材料。

四、雙方於未簽署授權契約前，乙方及乙方研發人不得將本材料或修改材料或其他甲方所有與前述二者相關之專利做任何商業利用。乙方充分瞭解甲方並無授權予乙方之義務，且甲方得於不違背第三人既有權利或依法所應負義務之情形下，將全部或部分與本材料有關之權利，以專屬或非專屬授權、販賣或轉讓之方式移轉予第三人。

五、於不影響甲方權益之情形下，乙方得將其利用本材料研發所得之修改材料移轉予非營利機構，但其用途應限定為研究及教學之用。乙方應確保非營利機構之權利義務不得違反本契約之約定，甲方得要求乙方與非營利機構簽署一份與本契約內容同等之契約。

六、乙方可提出其因使用本材料所得研發成果之專利申請案。但乙方擬就修改材料或本材料之製造方法或使用方法提出專利申請時，應事前以書面通知甲方。

第五條：材料移轉費用及交付

一、□乙方無須支付甲方費用。

□乙方應自本契約雙方完成簽署日期起算_____日內，以匯款全額支

付甲方新臺幣_____元整，不得扣除手續費或其他各種費用，並於匯款後通知甲方。甲方匯款帳戶資料如下：

匯款銀行	臺灣土地銀行南港分行
戶名	中央研究院科學研究基金 401 專戶
匯款代號	004056030625

乙方匯款後之通知，應以電子郵件方式將匯款日期、金額、契約覽號等資訊通知甲方 ipttcpmg@gate.sinica.edu.tw 信箱，俾確認匯款情形。

二、 材料經甲方交付運輸，即視為完成交付。自交付運輸時起，材料如於運輸過程中發生毀損、滅失或其他風險，應由乙方自行負責。但如前述風險係因甲方之故意或重大過失所致者，不在此限。

第六條：無擔保條款

一、本材料屬於實驗性質，可能具有危險性，甲方對本材料不擔保其有效性、合用性、商品化之可能性、無瑕疵，或其他任何明示或默示之擔保，亦不擔保乙方未取得適當授權而使用本材料，不侵害他人專利或其他智慧財產權。

二、本材料係依本契約簽署時之現況移轉，乙方充分瞭解且同意乙方因使用、存放或處置本材料所發生之一切費用及損失，除因甲方之故意或重大過失外，應由乙方負擔，第三人向乙方主張權利時亦同；如係可歸責於乙方之事由而造成甲方任何損害，包括但不限於甲方因訴訟或行政機關之調查所支出之賠償、補償、法律費用或行政成本等，均應由乙方負擔。

第七條：保密義務

一、本契約所指之機密資料包括乙方因本契約而知悉或持有之非眾所周知之所有資料、其他相關資料及本契約之有償對價。乙方應採取一切合理、有效且適當之保密措施，將機密資料予以妥善保管。如乙方依本契約第四條第一項公開發表與本材料相關之研究成果，應依本契約之相關約定辦理。

二、乙方應事前取得甲方之書面同意始得於與第三人合作時使用本材料。

第八條：本契約期間及終止或解除之效果

一、□本契約自雙方完成簽署日起生效，並繼續有效_____年止。

□本契約自雙方完成簽署日起生效，並繼續有效至甲方交付原始材料之日起____年止。

二、本契約於下列情事發生之日終止或解除（以最先發生之日期為準）：

(一) 乙方已完成使用本材料之研究；或

(二) 一方以書面於三十日前通知他方終止本契約；或

(三) 本契約期間屆滿。

(四) 乙方未依第五條約定於約定期限內全額支付甲方費用。

三、如乙方得自其他管道取得本材料，應檢附相關證明資料通知甲方，並經雙方合意終止本契約。

四、如甲方依第二項第二款終止本契約，非因乙方違約或本材料對健康有立即之危害或涉及專利侵權之情事者，則乙方為完成相關之研究工作，得請求甲方給予自甲方通知終止本契約之日起算至多一年之寬限期。

五、若本契約因第二項而終止者，乙方應停止使用本材料，並將本材料剩餘部分歸還或銷毀。就修改材料部分，乙方得選擇銷毀，或依本契約對修改材料之約定使用之。

六、若本契約提前終止，甲方已收取之款項無須返還乙方。

七、本契約第四條 （權利歸屬及運用）、第六條（無擔保條款）、第七條（保密義務）、第九條（準據法及管轄法院）、本條（本契約期間及終止之效果）及依其性質應繼續有效之條款不因本約之終止而失其效力。

第九條：準據法及管轄法院

一、因本契約之訂立、效力、解釋、履行及爭議悉依中華民國法令解釋及適用之，本契約未約定事項，悉依中華民國相關法令、習慣及平等互惠之原則解決之。

二、任何與本契約相關或因本契約所生之爭議而涉訟者，雙方合意以臺灣臺北地方法院或智慧財產及商業法院為第一審管轄法院。

第十條：完整合意

一、本契約及其附件構成雙方對本案完整之合意。任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約或其附件之事項，對雙方皆無拘束力。本契約之修改應經雙方以書面為之並經合法授權代表人簽署。

二、附件之效力與本契約同，惟若兩者有牴觸時，以本契約為準。

第十一條：　契約份數

本契約壹式貳份，由甲、乙雙方各執壹份為憑。

立約人已於合理期間內審閱本契約全部條款內容，茲承諾並簽章如下：

甲　　方：　中央研究院

代 表 人：　院長 陳建仁

授權簽約人：蔡宜芳

職　　稱：　副院長

通訊地址：　115201 臺北市南港區研究院路二段 128 號

日　　期：＿＿＿＿＿＿＿＿

甲方研發人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(簽名或蓋章)

職　　稱：＿＿＿＿＿＿＿＿

所（處、中心）：＿＿＿＿＿＿＿＿

電　　話：＿＿＿＿＿＿＿＿

日　　期：＿＿＿＿＿＿＿＿

乙　　方：＿＿＿＿＿＿＿＿

代 表 人：＿＿＿＿＿＿＿＿

授權簽約人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(簽名或蓋章)

職　　稱：＿＿＿＿＿＿＿＿

通訊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

電　　話：＿＿＿＿＿＿＿＿

機密

日　　期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方研發人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(簽名或蓋章)

職　　稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通訊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電　　話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日　　期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

樣張